

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录汇总表

(2024年7月4日)

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	天虫资本 李星雨、中银资管 周喆、有唯投资 王克林、世纪自营 李时樟、谢诺辰阳 林浩、中泰自营 李硕文、中海基金 谈必成、招商资管 吴彤、国信证券 欧阳仕华、第一创业资管 杜欢欢、招商信诺 刘泽宇、安信资管 林芸、长城资管 彭思宇、兴证全球 张荣朗沐、蓝海基金 张俊、致合资管 张珂畅、固禾基金 王生瑞、纽富斯投资 戚锦锭、民沣基金 陈诤、源乐晟 吴雨哲、财沣投资 吕喆、涌瑞基金 杨文亮、海雅金控 冉亚林、太平洋证券 李珏晗、华福证券 谢文嘉、广发证券 杨琳琳、东方财富证券 袁泽生、中信证券 郑凯航、东方财富证券 刘琦、丹羿投资 郭沛瑶	
<b>会议时间</b>	2024年7月4日 13:00-16:00	
<b>会议地点</b>	佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室	
<b>上市公司接待人员姓名</b>	CEO、总经理 何瀚 惠州佰维总经理 刘昆奇 战略部负责人 肖博天 董办工作人员	
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。 <b>一、参观情况</b> 本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。  <b>二、交流环节：</b> <b>Q1. 公司 SSD 产品已进入哪些大客户？</b> A1：公司 SSD 产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名 PC 厂商；在国产 PC 领域，公司是 SSD 产品的主力供应商，占据优势份额。  <b>Q2. 各大终端厂商都在发力 AI，公司在 AI 相关的业务有什么布局？</b> A2：公司与 OPPO、传音等主要的 AI 手机厂商和 HP、联想、Acer 等主要的 AIPC 厂商建立了密切的合作关系，新产品在不断导入。公司面向 AI 手机已推出 UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品；面向 AIPC 已推出 DDR5、PCIe4.0 等高性能存储产品；面向 AI 服务器，已推出企业级 SATA SSD、企业级 PCIe SSD、RDIMM 和 CXL 内存等产品。公司始终保持敏锐洞察力，面对 AI 端侧设备本地化部署和轻量化模型的发展趋势，积极探索存储创新应用，赋能新兴终端应用的规模化落地。	

<p><b>Q3. 目前原厂价格上涨幅度有所收敛，请问公司是否还会延续去年较为激进的备货策略？</b>  A3：公司 2023 年在行业周期低点加强战略备库，为行业复苏积极准备。2024 年一季度公司采取较为中性的备货策略，按需采购，一季度末存货金额与 2023 年末基本持平，预计将继续保持按需采购的备货策略。</p> <p><b>Q4. 存储行业上半年景气度较高，目前来看，存储行业供需情况及行业趋势如何？</b>  A4：三季度国内需求有所回落，但受北美 AI 服务器需求迅猛增长的影响，整体价格仍有支撑，当前国内供需关系较为焦灼，但从中期来看行业景气度有望延续。</p> <p><b>Q5. 公司定增中的“晶圆级先进封测”主要覆盖的是哪些技术？</b>  A5：公司“晶圆级先进封测”主要是实现凸块（Bumping）、重布线（RDL）、扇入（Fan-in）、扇出（Fan-out）、2.5D、3D 等工艺技术。</p> <p><b>Q6. 惠州佰维是公司主要的生产基地，目前的技术能力以及未来规划如何？</b>  A6：惠州佰维专精于存储器封测及 SiP 封测，封装工艺国内领先，目前掌握 16 层叠 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平。惠州佰维目前主要服务于母公司的存储芯片封测需求，未来，随着产能不断扩充，惠州佰维将利用富余产能向存储器厂商、IC 设计公司、晶圆制造厂商提供代工服务。</p> <p><b>Q7. 公司在持续发力主控芯片环节，目前公司主控芯片有什么进展？为什么选择在主控芯片环节加强投入？</b>  A7：公司推出的第一颗主控芯片性能优异，产品目前已回片验证，进行量产准备。公司将持续加大芯片设计的研发投入力度，为打造服务 AI 时代高性能存储器奠定坚实的技术基础，提升公司在产业链的价值占比，进而提升公司盈利能力。</p> <p><b>Q8. 看到公司在封测市场有存储器封测和晶圆级先进封测的布局，目前先进封装行业市场规模有多大？</b>  A8：根据 Yole 的预测，全球先进封装在集成电路封测市场中所占份额将持续增加，预计到 2026 年，全球封测市场规模将达到 921 亿美元，先进封装市场规模将达到 459 亿美元，约占据封测市场 50% 的份额。</p> <p><b>Q9. 公司盈利能力在不断修复，请问公司利润水平上行的驱动力是什么？</b>  A9：公司将把握行业上行机遇，实现营收与利润的历史性突破。首先是在手机、PC、服务器等领域着力扩大客户覆盖面，做大营收，力争突破一线客户；其次是聚焦智能穿戴和工车规领域等定制市场并投入战略性资源，这些市场市占率的提升和市场空间的成长也是提升公司利润水平的关键因素；再次，公司拥有丰富的消费类产品的开发能力和经验，2024 年也将重点发力自有 C 端品牌的建设；同时，公司已布局了全球分布的立体化销售/生产交付网络，可以提</p>
--

	<p>升全球市场占有率；最后，公司在主控和先进封测方面的布局能够提升公司在产业链的价值占比，进而提升利润水平。</p> <p><b>Q10. 公司惠州制造基地目前的自动化水平如何？</b></p> <p><b>A10:</b> 公司通过芯片封装设备、模组制造设备以及测试设备系统的一体化智能联机运行，实现高度自动化及制造过程的全程可追溯性。通过设备联机化改造及 AGV 机器人的导入，芯片封测生产模块目前可达到 99% 自动化生产水平，模组制造测试模块目前可达到 91% 自动化生产水平。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2024 年 7 月 4 日
<b>备注</b>	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。